



メック株式会社

証券コード：4971

第49期

株主通信

平成29年4月1日から平成29年12月31日まで

界面創造

Creating Surface Possibilities

P1~4 TOP Interview 社長に聞く今期の業績と今後の計画

P4 Our Products 超簡単! 製品紹介

P5 見てわかる財務指標

P6 会社概要 / 株式の状況

社長に聞く今期の業績と今後の計画 TOP Interview



代表取締役社長
前田 和夫

5G/IoT/自動運転市場に向けて、当社コア技術の展開・深化を進め、周辺領域を幅広くリサーチし、新ビジネス創出を目指します。

株主の皆様には平素より当社グループへのお引き立て厚く御礼申し上げます。ここに当社第49期の事業の報告をお届けするに当たり、ご挨拶申し上げます。

🔍 今期のポイント

- 5G/IoT/自動運転の進展を支えるコア技術を深化。新分野のリサーチに注力。
- 日本含めて東アジア全般が堅調。
- 電子基板の技術革新と半導体市場の拡大を背景に、薬品売上が増加。

Q 今期の事業環境と業績はどうでしたか。
A スマートフォン・クルマ市場で拡販進み、ディスプレイ、高密度電子基板向けが好調。

当連結会計年度※(平成29年4月1日～平成29年12月31日)におけるわが国経済は、IT産業を中心とする輸出の回復や、堅調な雇用・所得情勢から個人消費の復調が見られる等、緩やかな回復基調にあったものの、米国政権の動向や世界的な地政学リスクに対する懸念の高まり、為替の動向等から景気の先行きへの懸念は継続しています。

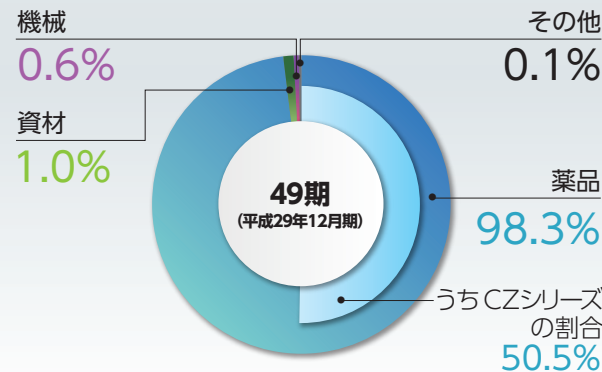
電子部品業界ではスマートフォンに使用される電子部品の高機能化や小型化が進んでいます。そのため、電子部品を

決算期変更のお知らせ 平成29年12月期は、決算期変更による経過期間となります(日本単体9ヶ月/4～12月、海外子会社は従来通り12ヶ月/1～12月)

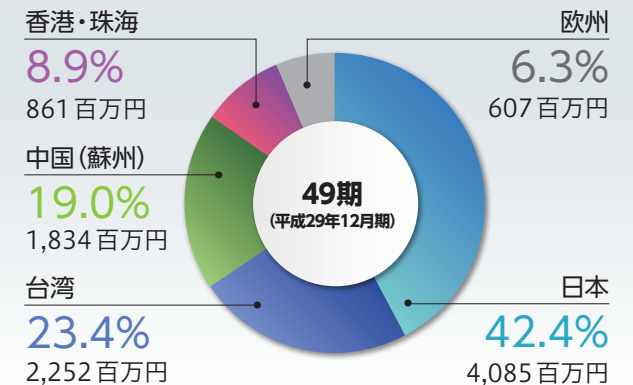
今期の実績

	48期 (平成29年3月期)	49期 (平成29年12月期)
売上高 (百万円)	9,259	9,641
営業利益 (百万円)	1,887	1,993
経常利益 (百万円)	1,888	2,063
親会社株主に 帰属する当期 純利益 (百万円)	1,642	1,567
1株当たり 当期純利益 (円)	84.86	81.77

売上高に占める品目別割合(%)



地域セグメント別売上高比率(%) / 売上高(百万円)



搭載する電子基板も高密度化の傾向にあり、技術革新が進んでいます。また、半導体市場の拡大により、それを搭載するパッケージ基板生産量が増加し、クルマの電装化も業界の拡大を牽引しています。

IoT[■]関連市場は引き続き高い成長が見込まれ、移动通信システムの高容量の第5世代(5G)への切り替えに注目が集まっており、高速通信処理に対応可能な電子基板が必要になります。また、クルマの自動運転技術も着実に進んでおり、使用されるミリ波レーダーやカメラ等のセンサー類の需要が大きく拡大しており、これらを搭載するパッケージ基板が増加しています。さらに、将来の電気自動車へのシフトが明確となり、これに伴う電子基板も拡大すると考えています。

このような環境のもと、今期の売上高は96億41百万円、営業利益は19億93百万円、経常利益は20億63百万円、親会社株主に帰属する当期純利益は15億67百万円となりました。

※ 平成29年12月期は、決算期変更による経過期間となります(日本単体9ヶ月/4~12月、海外子会社は従来通り12ヶ月/1~12月)

■ IoT(Internet of Things) あらゆるモノがインターネットにつながり、人々の暮らしや産業を変える仕組み

Q
A 製品別の販売状況を教えてください。
密着向上剤、エッチング剤等 全般的に好調。

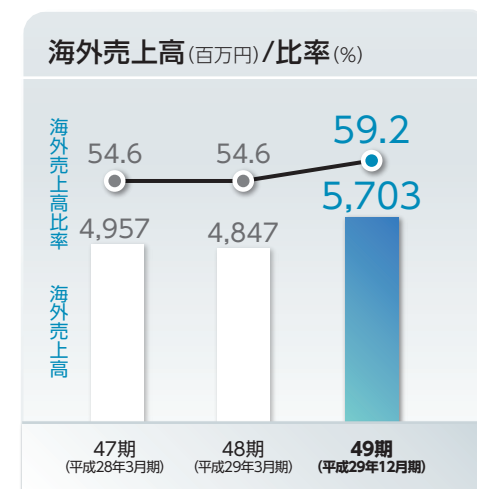
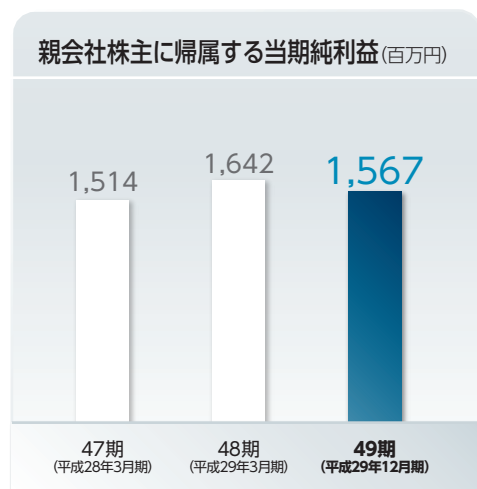
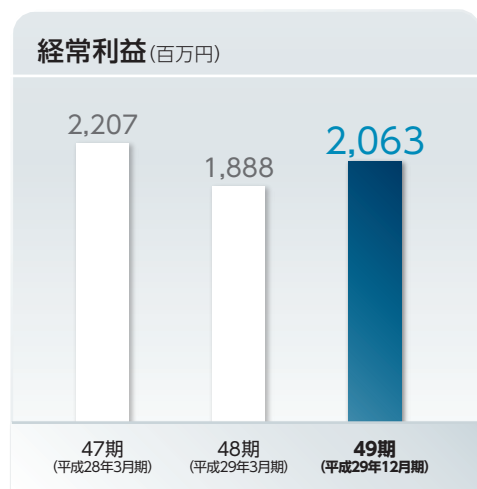
当社グループの売上高の内訳は、薬品売上高は94億80百万円、機械売上高は56百万円、ドライフィルムや銅箔等の資材売上高は94百万円、修理等のその他売上高は9百万円となりました。薬品の売上高全体に占める割合は98.3%となりました。薬品売上高の内訳は、密着向上剤[■]は54億37百万円、エッチング剤[■]は32億90百万円、その他薬品は7億51百万円となりました。

密着向上剤CZシリーズの売上高は、47億87百万円となり、薬品売上高に占める割合は50.5%となりました。CZシリーズは、高い信頼性によりクルマ向け自動運転センサー類搭載基板に採用が広がりました。また、電子基板のさらなる高密度化に対応するため、新製品の販売も開始しました。スマートフォンやクルマ、ロボット等に用いられる、フレキシブル基板や

リジッド基板等の銅の種類を選ばずに粗化できるUTシリーズは、拡販を進めた結果、基板メーカーでの量産が始まりました。Vボンドシリーズは、HDI基板[■]向けが堅調に推移しました。IoTやAI(人工知能)で必須となる高速通信処理に対応する高周波基板向けフラットボンドは、少量ながら顧客への安定的な供給を続けており、今後は5Gへの切り替えとともに拡大する方向にあります。

エッチング剤では、タッチパネルセンサー向けで銅だけをエッチングすることを特徴とする選択エッチング剤[■]SFシリーズの売上が拡大しました。今後もこの傾向は続くと考えています。ディスプレイ用COF[■]向けで高いシェアを獲得しているエッチング剤EXEシリーズは、スマートフォンに搭載するHDI

- 密着向上剤 金属と樹脂との密着を向上させる特徴を持つ薬品
- エッチング剤 金属を溶かす薬品
- HDI(High Density Interconnection)基板 主にスマートフォン向けに搭載される高密度な基板
- 選択エッチング剤 AとBの異なる金属が共存する場合に一方の金属だけをエッチングする薬品
- COF(Chip On Film) ポリイミドのフィルム状基板に直接半導体チップを搭載する実装技術



基板向けが引き続き順調に推移しました。

その他銅表面処理剤では、選択エッチング剤CHシリーズの売上が拡大しました。CHシリーズは、ニッケル-クロム合金だけをエッチングする薬品で、主にフレキシブル基板向けに採用されています。金属と樹脂とを直接接合する技術である「アマルファ」は一部の携帯端末の金属筐体を製造する工程で使用されていますが、販売面で苦戦しており、新規顧客獲得に向け営業活動に取り組まれました。

Q 地域別の販売動向はどうでしたか。
A 日本含め東アジア全般に堅調。

地域セグメント別では、日本単体では、日本国内の販売はディスプレイ向けを中心に伸長し、東南アジアや韓国では電子基板向けが順調に推移しました。その結果、売上高は40億85百万円、セグメント利益は14億10百万円となりました。

台湾では、ディスプレイ向けパッケージ基板や高密度電子基板用薬品が堅調に推移しました。その結果、売上高は22億52百万円、セグメント利益は2億85百万円となりました。

香港・珠海では、汎用電子基板市場で売上が堅調に推移しました。その結果、売上高は8億61百万円、セグメント利益は1億4百万円となりました。

蘇州では、スマートフォン向けHDI基板用薬品が順調に推移しましたが、販売単価の下落により利益は前期に比して減少しました。その結果、売上高は18億34百万円、セグメント利益は2億22百万円となりました。

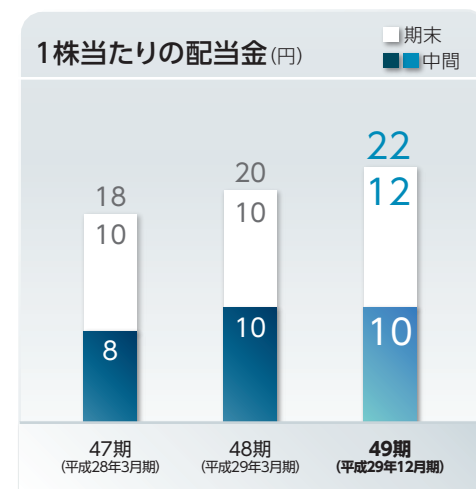
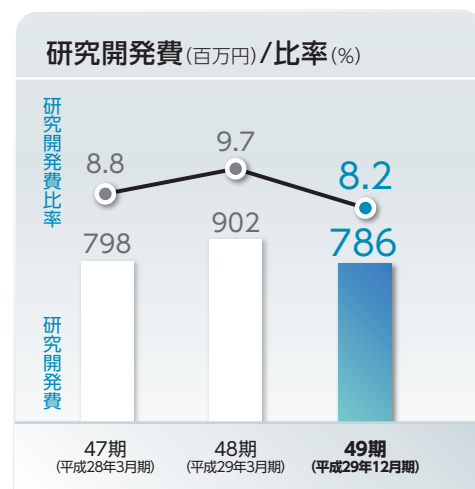
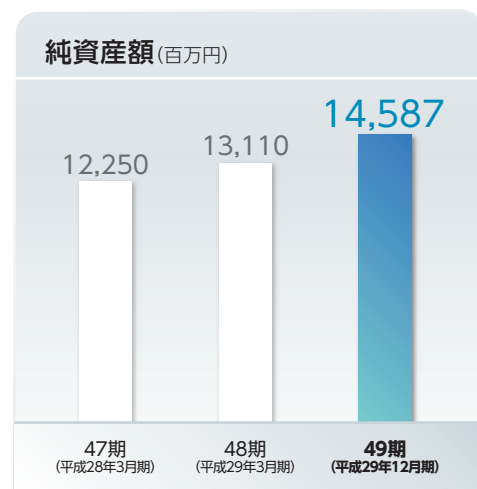
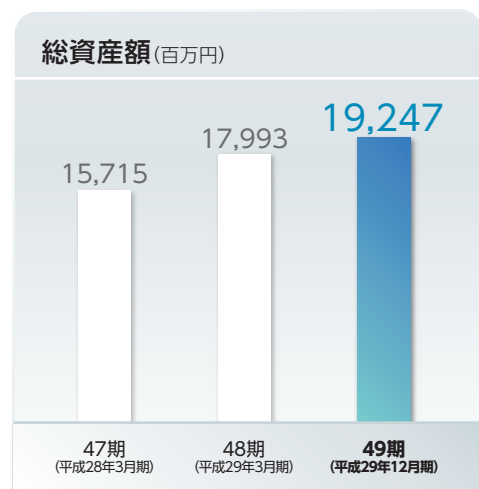
欧州では、電子基板業界全体が低迷の状況にありますが、新規顧客の獲得等により売上、利益ともに堅調に推移しました。その結果、売上高は6億7百万円、セグメント利益は86百万円となりました。

タイは、平成29年5月29日にタイ王国での子会社設立手続きが完了しました。稼働に向けて準備段階であったことから、売上への貢献はなく、セグメント損失は20百万円となりました。なお、操業開始は平成31年を予定しています。

Q 今後の見通しと事業戦略を教えてください。
A 5G/IoT/自動運転関連市場の技術変化に対応して、コア技術の深化と拡充に努めます。

社会の各分野に変革をもたらすIoTとその普及に欠かせない5G通信。これらの技術が融合する自動運転。近年これらの技術が本格的に立ち上がりつつある中において、各種センサーやメモリー、情報処理や通信制御を行う半導体の需要が拡大するとともに、使用されるパッケージ基板は増加し、多種多様化しています。

当社製品は、金属表面を粗化し密着性を向上させる技術、微細配線を形成する技術、選択的に金属をエッチングする技術、金属表面を化学処理し密着性を向上させる技術をコアとして、さまざまな電子基板・部品製造工程で使われてきましたが、当社の活躍する分野は今後ますます拡大すると予想しています。5GやIoT、自動運転等では、超高速・大容量処理が必要となり、



また、信号の遅延が起らないようにする技術が必須となります。これらの技術の変化に対して密着向上剤のCZやUT、フラットボンダが活躍できる市場が拡大すると考えています。また、エッチング剤のEXEシリーズもこれらの技術の変化に伴い配線の微細化が進んでいく中で必要性が一層高まっていくと見ています。さらにこれらの技術変化を見据え必要な新製品の開発にも注力していきます。

今後とも電子基板・部品の技術変化に対応して収益を確保するとともに、コア技術の深化と拡充に努めていきます。

Q 研究開発方針について伺います。

A **周辺領域を幅広く
とらえたりサーチを行い、
新たな商機創出を目指します。**

当社はこれまで目まぐるしく変わる技術動向を見据えて、技術マーケティングを行い、それに対応すべく先行開発を進めてきました。そのために連結売上高の約10%を研究開発に投資し続け、その成果がようやく求められる時代になったと実感しています。

「薬品」という化学の領域から最先端のハードウェアの製造プロセスをサポートする。それが当社の優位性を発揮できる事業ドメインであり、そこに注力していく方針は変わりません。そのうえで今後の研究開発の方向性としては、広く周辺技術領域のサーチに力を入れ、シーズを探索し、新たな商機を見出すことを目指しています。そのことが当社のポテンシャルを高めることにつながります。そのために余力を持って研究開発に取り組めるよう本格稼働した尼崎事業所を拠点に新たな分野の研究開発に注力し、次代に向けた展開を果敢に進めていきます。

Q 投資計画・資本政策について教えてください。

A **拡大するニーズに対応するため、
生産設備を増強。年間配当金は
1株当たり22円の予定です。**

投資計画につきましては、世界各市場の需要に即応したグローバル展開と技術の進展を見据え、今後拡大する東南アジア市場を深耕するために平成29年5月29日、タイに6社目の子会社を設立し、平成31年の操業開始に向け準備を進めています。また拡大する生産量に対応すべく国内工場も拡充していきます。

配当金につきましては従来どおり、安定配当の考え方のもと期間利益の反映を図る所存で、配当性向は30%を念頭に置いています。今期配当は前年対比1株当たり2円増配し、期末配当金12円、実施済みの中間配当金と合わせて年間22円とさせていただきます。配当性向は26.9%となっています。

また、今期の連結ROEは11.3%となりました。これは、尼崎事業所完成による減価償却費や人件費の増加によるものです。今後とも売上増加を図りつつ経営の効率化を進め、ROEの向上を図っていく所存です。来期における配当につきましては、景気の先行きに不透明感はありますが、1株当たり中間配当金12円、期末配当金12円の年間配当金24円を予定しています。



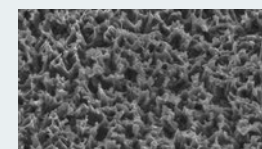
**電子基板の
技術革新を支え、
進化する世界標準
製品「CZシリーズ」**

銅表面に微細な凹凸形状を作ることで、銅と樹脂の密着強度を高めるCZシリーズは、半導体パッケージ(PKG)基板をはじめとする電子基板の製造工程において世界中で使用されています。一般に電子基板は絶縁体である樹脂に銅の配線パターンを形成しますが、発熱等で銅と樹脂が剥がれる不良が発生します。それを防ぐためCZシリーズでは、銅表面を数 μm 溶かし超微細で独特な凹凸形状を形成。その間に樹脂が入り込むことで高い密着性を実現しています。

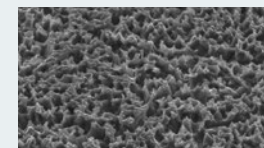
現在シリーズとしてラインナップしているCZ-8100は、クルマの安全機能を司るカメラやミリ波レーダー等を搭載するPKG基板にも使われ、CZ-8101は、パソコンやスマートフォン、タブレットPC等のPKG基板に広く使われています。また、新製品CZ-8201の販売も開始いたしました。研究開発ではさらなる超粗化に向けた開発にも取り組んでいます。



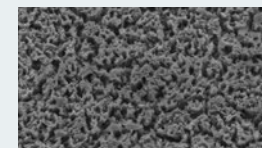
処理前



CZ-8100 1.5 μm



CZ-8101 1.0 μm



CZ-8201 0.5 μm

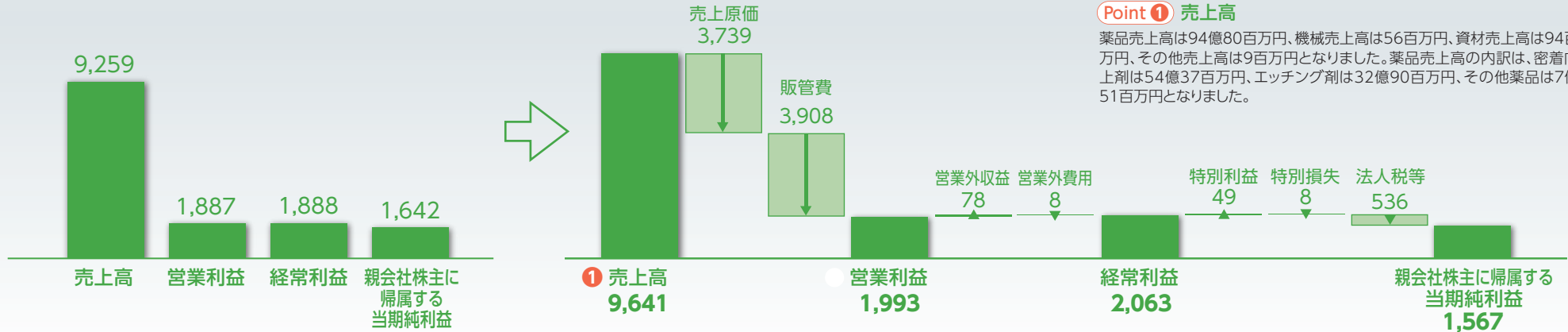


連結損益計算書の概要 (百万円)

決算期変更のお知らせ 平成29年12月期は、決算期変更による経過期間となります(日本単体9ヶ月/4~12月、海外子会社は従来通り12ヶ月/1~12月)

前期 (平成28年4月1日~平成29年3月31日)

今期 (平成29年4月1日~平成29年12月31日)



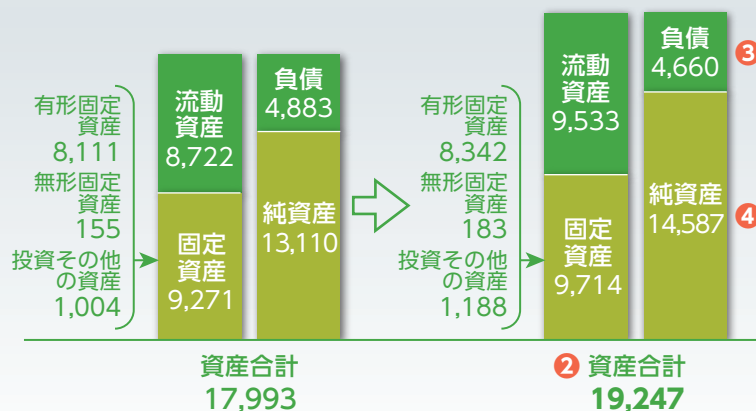
Point ① 売上高

薬品売上高は94億80百万円、機械売上高は56百万円、資材売上高は94百万円、その他売上高は9百万円となりました。薬品売上高の内訳は、密着向上剤は54億37百万円、エッチング剤は32億90百万円、その他薬品は7億51百万円となりました。

連結貸借対照表の概要 (百万円)

前期末 (平成29年3月31日)

今期末 (平成29年12月31日)



Point ② 資産合計

売上の増加、機械装置及び運搬具の増加等により、前連結会計年度末に比べ12億54百万円増加し、192億47百万円となりました。

Point ③ 負債

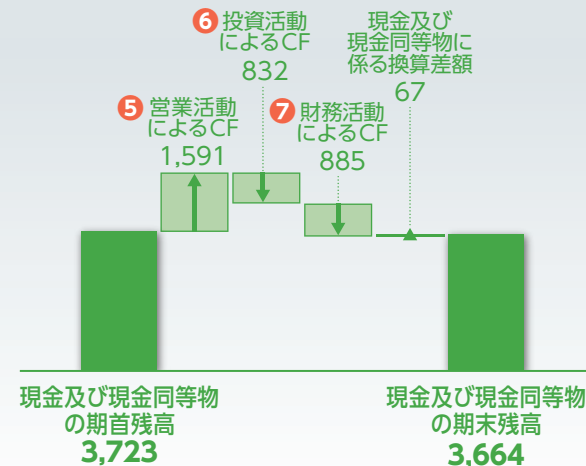
尼崎事業所建設関係の借入金や設備関係未払金の減少等により、前連結会計年度末に比べ2億23百万円減少し、46億60百万円となりました。

Point ④ 純資産

親会社株主に帰属する当期純利益の計上による利益剰余金の増加、為替換算調整勘定の増加等により、前連結会計年度末に比べ14億77百万円増加し145億87百万円となりました。

連結キャッシュ・フロー計算書の概要 (百万円)

今期 (平成29年4月1日~平成29年12月31日)



Point ⑤ 営業活動によるCF

得られた資金は15億91百万円。これは主に税金等調整前当期純利益が21億4百万円、売上債権が7億58百万円増加したこと等によるもの。

Point ⑥ 投資活動によるCF

使用した資金は8億32百万円。これは主に有形固定資産の取得による支出が8億14百万円あったこと等によるもの。

Point ⑦ 財務活動によるCF

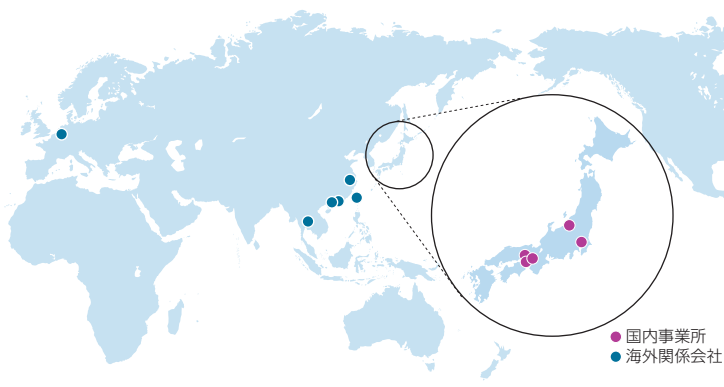
使用した資金は8億85百万円。これは主に長期借入金の返済5億円及び配当金の支払いが3億85百万円あったことによるもの。

会社概要

商号	メック株式会社
本社事務所所在地	兵庫県尼崎市杭瀬南新町三丁目4番1号
設立年月日	1969年(昭和44年)5月1日
資本金	594,142,400円
事業内容	電子基板・部品製造用薬品の製造販売 および機械装置、各種資材の販売

取締役および執行役員

代表取締役社長	前田 和夫
取締役専務執行役員	長井 眞
取締役常務執行役員	中川 登志子
取締役(社外)	西山 豊
取締役 監査等委員会委員長(社外)	前田 勝廣
取締役 監査等委員(社外)	佐竹 隆幸
取締役 監査等委員(社外)	田中 明子
常務執行役員	北村 伸二
執行役員	木田 哲郎
執行役員	中村 幸子
執行役員	武村 文夫



国内事業所

本社・尼崎事業所
〒660-0822 兵庫県尼崎市杭瀬南新町三丁目4番1号 TEL. 06-6401-8160(代) FAX. 06-6401-8165
東京営業所
〒190-0003 東京都立川市栄町六丁目1番1号 立飛ビル7号館7階 TEL. 042-538-1080(代) FAX. 042-538-1090
長岡工場
〒940-2045 新潟県長岡市西陵町221番地36 TEL. 0258-47-2490(代) FAX. 0258-47-2493
西宮工場
〒663-8142 兵庫県西宮市鳴尾浜二丁目1番19号 TEL. 0798-46-8588(代) FAX. 0798-46-8688

海外拠点

MEC TAIWAN COMPANY LTD.
No.3, Ziqiang 6th Rd., Zhongli Dist., Taoyuan City 320, Taiwan (R.O.C.) TEL. +886-3-434-3549 FAX. +886-3-434-5047
MEC EUROPE NV.
Kaleweg 24-26, B-9030 Gent, Belgium TEL. +32-9-216-7272 FAX. +32-9-216-7270
MEC (HONG KONG) LTD.
No.8, 12/F., Tower 3 China Hong Kong City, 33 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong TEL. +852-2690-2255 FAX. +852-2690-2262
MEC FINE CHEMICAL (ZHUHAI) LTD.
530 An Ji East Road, Sanzao Town, Jinwan Qu, Zhuhai City, Guang Dong 519040, China TEL. +86-756-762-2328 FAX. +86-756-762-2628
MEC CHINA SPECIALTY PRODUCTS (SUZHOU) CO., LTD.
31 Linjiang Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu 215121, China TEL. +86-512-6745-1990 FAX. +86-512-6745-1993
MEC SPECIALTY CHEMICAL (THAILAND) CO., LTD.

株主状況

発行済株式総数	20,071,093株
株主数	5,132名

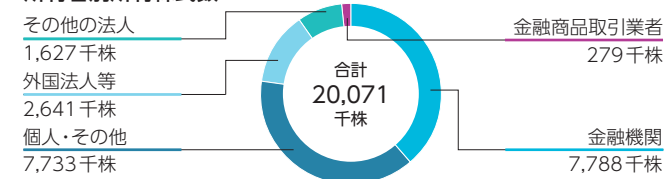
大株主の状況

株主名	当社への出資状況	
	所有株数(千株)	持株比率(%)
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)	3,518	17.52
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	1,224	6.09
株式会社マエダホールディングス	1,199	5.97
前田 耕作	1,005	5.00
前田 和夫	726	3.61
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9)	644	3.21
野村信託銀行株式会社(投信口)	612	3.05
メック取引先持株会	522	2.60
資産管理サービス信託銀行株式会社(証券投資信託口)	413	2.05
J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. 380578	371	1.84

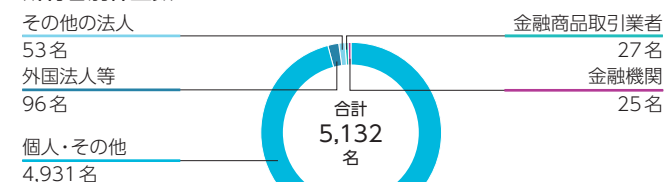
※ 当社は自己名義株式を763,914株保有していますが、上記大株主からは除外しています。

株式分布状況

所有者別所有株式数



所有者別株主数



※ 「個人・その他」には自己名義株式を763,914株含んでいます。

株主メモ

事業年度 毎年1月1日から12月31日まで

期末配当金
受領株主確定日 毎年12月31日

中間配当金
受領株主確定日 毎年6月30日

定時株主総会 毎年3月

単元株式数 100株

株主名簿管理人
および特別口座
の口座管理機関 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社

株主名簿管理人
事務取扱場所 大阪市中央区北浜四丁目5番33号
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部

郵便物送付先 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号

※電話照会先 TEL. 0120-782-031 (通話料無料)

インターネット
ホームページURL <http://www.smtb.jp/personal/agency/index.html>

上場証券取引所 東京証券取引所市場第一部

証券コード 4971

公告の方法 電子公告により行う。
公告掲載URL
<http://www.mec-co.com/ir/denshi/>
(ただし、電子公告によることができない事故、その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に公告いたします。)

ニュースメール配信サービスのご案内

当社では、ホームページにニュースリリースや新しいコンテンツが掲載された際に、ご登録者の皆様にそのタイトルとURLを電子メールにてお知らせするサービス(ニュースメール配信サービス)を行っています。

ご希望の株主様には、こちらのサービスの送信先メールアドレス(携帯電話のメールアドレス不可)を、当社ホームページまたは、RIMSNET (<https://rims.tr.mufg.jp/>) から、簡単にご登録いただけます(無料)。

アンケートのお願い

当社では、株主の皆様とのよりよいコミュニケーションを目指し、今後も業績情報の開示の充実に努めていきたいと考えています。

つきましては、この株主通信に対するご意見、ご感想をお聞かせいただきたくアンケートにご協力をお願いいたします。

ホームページのご紹介

当社のホームページでは

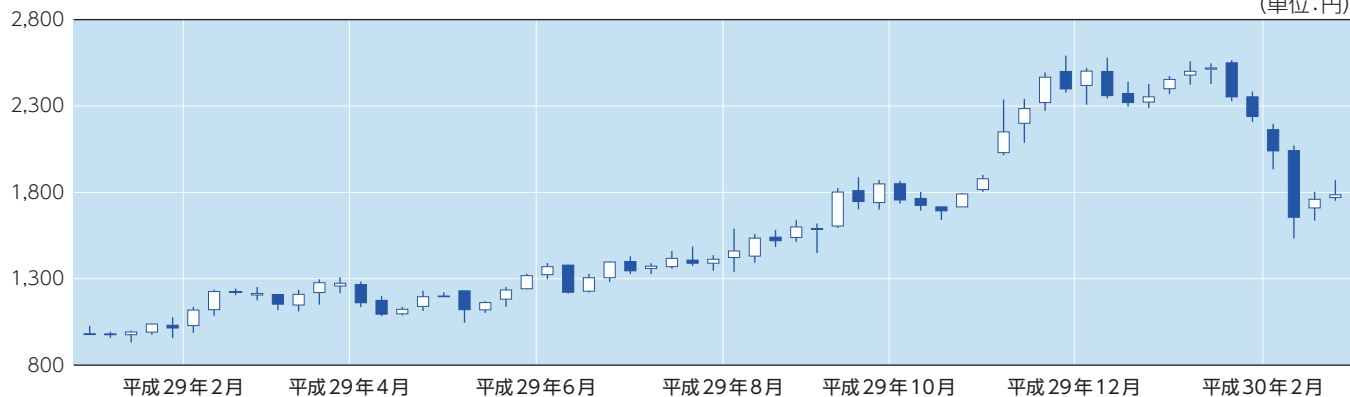
- プレスリリース
- 株主通信
- コーポレート・ガバナンス報告書 他

各種情報を掲載しています。ぜひご覧ください。



<http://www.mec-co.com/>

株価の推移 (平成29年1月～平成30年2月)



メック株式会社

本社事務所 / 〒660-0822
兵庫県尼崎市杭瀬南新町三丁目4番1号
TEL. 06-6401-8160 FAX. 06-6401-8165

URL <http://www.mec-co.com/>

株式に関する住所変更等の お手続きについてのご照会

1. 証券会社の口座をご利用の株主様は、三井住友信託銀行株式会社ではお手続きができませんので、取引証券会社へご照会ください。
2. 証券会社の口座をご利用でない株主様は、左記電話照会先※までご連絡ください。

